

RFスパッタ装置 SP-31000R



成膜室が大きく、小物基材への成膜を目的とした中量産用装置です。基板取付台は公転と自転が個別に動作でき、任意のターゲット上で自転だけの操作も可能です。ターゲットに対する基板の傾き角も変えることが可能で、強い異方性スパッタリングが出来ます。

RFスパッタ装置 SP-31000R仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁵ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄15分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ700mm×400mmH
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 1KW 自動マッチング 1台
○基板形状	φ25mm 7枚
○膜厚分布	±15%以内
○ターゲット寸法	4インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	3
○基板回転	有り
○基板加熱	常温～250℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:900L/min クライオポンプ:1500L/sec
○操作方法	自動
○ガス系統	マスフローコントローラ 2系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相15KVA 冷却水:10L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:2500mmW×2000mmD×1800mmH